

上海晶丰明源半导体股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案）修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买四川易冲科技有限公司 100%股权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2025 年 7 月 3 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2025〕21 号）（以下简称“《审核问询函》”）；2025 年 8 月 20 日，公司已完成了《审核问询函》相关问题的回复，公司独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、评估机构就《审核问询函》中的相关事项进行核查并发表明确意见，并对《上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）予以修订，具体内容详见公司于 8 月 20 日刊载于上交所网站的相关公告；2025 年 11 月 13 日，公司基于本次交易的审计基准日更新至 2025 年 5 月 31 日，对《重组报告书》中的相关内容予以修订，形成了《上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《重组报告书（修订稿）》”）。

鉴于作为本次交易定价依据的评估报告的评估基准日为 2024 年 12 月 31 日，为维护公司及全体股东的利益，验证标的资产价值未发生不利变化，金证（上海）资产评估有限公司以 2025 年 5 月 31 日为加期评估基准日，对本次交易标的资产进行了加期评估。鉴于评估报告更新，同时根据上交所进一步审核意见，公司对《重组报告书（修订稿）》再次进行修订、补充及完善，主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或

简称具有相同的含义)：

章节	修订情况
重大事项提示	更新本次加期评估验证情况
第一章本次交易概况	更新交易对方做出的重要承诺
第三章交易对方基本情况	1、更新部分交易对方的穿透锁定安排、承诺及相关内容 2、更新交易对方存续期与锁定期匹配情况
第六章标的资产评估情况	更新本次加期评估验证情况

根据公司最新《公司章程》，调整了“监事会”“股东大会”相关表述，详见《重组报告书（修订稿）》楷体加粗部分内容。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 16 日